

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 24 年 3 月 29 日 (2012.3.29)

【公表番号】特表 2011-517113 (P2011-517113A)  
 【公表日】平成 23 年 5 月 26 日 (2011.5.26)  
 【年通号数】公開・登録公報 2011-021  
 【出願番号】特願 2011-504022 (P2011-504022)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L	23/50	U
H 0 1 L	23/50	R
H 0 1 L	23/50	H

【手続補正書】  
 【提出日】平成 24 年 2 月 13 日 (2012.2.13)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】特許請求の範囲  
 【補正対象項目名】全文  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【特許請求の範囲】  
 【請求項 1】

上側表面 (34)、下側表面 (36)、及び側壁 (38) を有するダイパッド (30) において、前記ダイパッド (30) が、前記上側表面 (34) に前記側壁 (38) に沿って形成される第 1 の窪み群 (42) と、及び、前記下側表面 (36) に前記側壁 (38) に沿って形成される第 2 の窪み群 (44) とを備える、前記ダイパッド (30) と、

前記ダイパッド (30) の周りに配置されるリード群 (32) と、  
 を備える、パッケージ化電子デバイス (20) 用リードフレーム (22)。

【請求項 2】

前記ダイパッド (30) は一定の厚さ (46) を有し、

前記第 1 の窪み群 (42) は前記ダイパッド (30) 内に前記上側表面 (34) から、前記厚さ (46) よりも短い第 1 の深さ (48) だけ延在し、及び、

前記第 2 の窪み群 (44) は前記ダイパッド (30) 内に前記下側表面 (36) から、前記厚さ (46) よりも短い第 2 の深さ (50) だけ延在する、

請求項 1 に記載のリードフレーム (22)。

【請求項 3】

前記第 1 の窪み群 (42) の前記第 1 の深さ (48)、及び前記第 2 の窪み群 (44) の前記第 2 の深さ (50) は、ほぼ等しい、請求項 2 に記載のリードフレーム (22)。

【請求項 4】

前記第 1 の深さ (48) 及び前記第 2 の深さ (50) の各々は、前記厚さの約 2 分の 1 である、請求項 2 に記載のリードフレーム (22)。

【請求項 5】

前記第 1 及び第 2 の窪み群 (42, 44) は半円形に設けられる、請求項 1 に記載のリードフレーム (22)。

【請求項 6】

前記第 1 及び第 2 の窪み群 (42, 44) は、前記ダイパッド (30) の端面に、かつそれぞれの上側表面 (34) 及び下側表面 (36) が前記側壁 (38) と交差する位置に設けられる、請求項 1 に記載のリードフレーム (22)。

## 【請求項 7】

前記ダイパッド(30)内に前記下側表面(36)から延伸する前記第2の窪み群(44)は、前記ダイパッド(30)内に前記上側表面(34)から延伸する前記第1の窪み群(42)に対して前記側壁(38)に沿って偏位している、請求項1に記載のリードフレーム(22)。

## 【請求項 8】

前記ダイパッド(30)の材料部分(62)は、前記第1の窪み群(42)と前記下側表面(36)との間に延伸し、及び前記ダイパッド(30)の前記材料部分(62)は、前記第2の窪み群(44)と前記上側表面(34)との間に延伸している、請求項7に記載のリードフレーム(22)。

## 【請求項 9】

前記ダイパッド(30)の材料部分(62)は、前記第1の窪み群(42)の各々の間に延伸し、及び前記ダイパッド(30)の前記材料部分(62)は、前記第2の窪み群(44)の各々の間に延伸している、請求項1に記載のリードフレーム(22)。